

珠海市半导体行业协会

珠半协秘〔2025〕21号

关于组织参加第二十二届中国国际半导体博览会（IC China 2025）的通知

各有关企业：

“第二十二届中国国际半导体博览会（IC China 2025）”将于2025年11月23-25日在北京国家会议中心召开。为推动我市国家外贸转型升级基地（集成电路）建设，促进珠海集成电路产业发展，帮助企业开拓国内外市场，提升区域品牌影响力，协会将组织我市集成电路企业抱团参加，现就有关事项通知如下：

一、展会情况

展会名称：第二十二届中国国际半导体博览会

展会时间：2025年11月23日-25日

展会地点：北京国家会议中心

主办机构：中国半导体行业协会

二、展品范围

IC设计：EDA、IP设计、嵌入式软件、数字电路设计、模拟与混合信号电路设计、集成电路布局设计等。

产业链：半导体材料和电子元器件、设备、制造、封测等。

创新应用：芯、光、车芯互联、具身智能与机器人、通信技术、商业航天/低空、新型储能、轨道交通芯片、电力芯片、信创芯片等。

协同服务：绿色与智能化建设、厂区建设、仓储运输、测试、洁净、泵阀、产业投资、法律援助等半导体配套服务产业。

元器件：电路类元器件、连接类元器件、机电类元器件、传感类元器件、功能材料类元件、光通信器件、量子器件、人工智能器件等。

三、展会亮点

中国国际半导体博览会（IC China）自 2003 年起已连续成功举办二十一届，是我国半导体行业年度最具权威和专业性的重大标志性活动，已成为顶级行业品牌盛会和业界标杆。

本届博览会以“全景链条展示、终端应用赋能、龙头企业带动”为工作主线，设立七大展区：IC 设计展区、产业链展区、创新应用展区、协同服务展区、元器件展区、海外展团、产教融合展区，展览规模为 50,000 平方米。大会同期举办开幕式及主旨论坛、第七年全球 IC 企业家大会、第八届半导体才智中国大会、第二十三届中国半导体封装测试技术与市场年会开幕式及主论坛等重要活动。

四、参展方式

请已购买独立展位的企业填写报名表，加入珠海展团抱团参展。未购买展位的企业，可以联系协会对接主办方咨询购买展位。

五、报名办法

请有意向参展的企业于 11 月 7 日前将以下资料整理汇总发送至协会邮箱 member@zhsia.org.cn。

- 1、参团报名表
- 2、公司及展品信息征集表（WORD 版本）
- 3、公司高清宣传图、LOGO 及产品图片(产品图以名称命名)
- 4、主办方展位合同、展位费付款水单（如已独立购买）

联系人：马岫 17377872077 金子杨 13726259646

邮 箱：member@zhsia.org.cn



附件

- 1、大会议程
- 2、参团报名表
- 3、企业及展品信息征集表